멈추지 않는 재계의 시계… 추석 연휴에도 종횡무진 행보

이재용 삼성전자 회장
해외사업장 점검·직원격려 예상
최태원 SK그룹 회장
미래사업 포트폴리오 구축할 듯
정의선 현대자동차그룹 회장
美 조지아 메타플랜트 방문 전망
구광모 LG그룹 회장
AI·밸류업 위한 구상 나설 것

이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터), 정의선 현대차그룹 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장.

'더도 말고 덜도 말고 한가위만 같아라'라는 말처럼 추석 연휴 가족들과 함께 즐겁게 보낼 생각에 마음이 들떠 있겠지만 재계 총수들은 미래 먹거리 확보를 위해 바쁜 시간을 보낼 전망이다.

국내 총수들은 글로벌 경기침체 장기화에 따른 불확실성 확대로 국내외 현장을 직접 방문하는 등 하반기 경영 구상에 집중할 방침이다. 여기에 연휴 직후 윤석열 대통령의 체코 순방길에 동행하는 만큼 그에 대한 준비에도 공을 들이고 있다.

11일 업계에 따르면 이재용 삼성전자 회장은 올해 추석 연휴에도 해외 사업장을 방문할 것으로 보인다. 이 회장은 과거에도 설과 추석 등 연휴에는 해외 사업장을 찾아 현지 사업을 점검하고 직원들을 격려해 왔다.

글로벌 기업 최고경영자(CEO)들과 비즈니스 미팅도 진행했다. 이 회장은 올해 설 연휴에 말레이시아 스름반 삼성SDI 생산법인을 찾아 배터리 1공장 생산 현장과 2공장 건설 현장을 둘러봤다. 또 수도 쿠알라룸푸르에서 현지 시장 반응을 살폈다. 지난해 추석에는 사우디아라비아와 이스라엘, 이집트 등 중동 3국을 찾았다.

최태원 SK그룹 회장은 국내에서 시간을 보내며 미래 사업 포트폴리오를 구축할 방침이다. 최 회장이 인공지능(AI) 밸류체인(가치사슬) 구축 등에 관심을 둔 만큼 미래 먹거리에 대해 고민할 것으로 보인다.

최 회장은 지난달 21일 '이천포럼 2024' 마무리 세션을 통해 "지금 확실하게 돈을 버는 것은 AI 밸류체인이며, 빅테크들도 경쟁 우위를 점하기 위해 많은 투자를 하고 있다"고 말한 바 있다. 그는 "중간에 덜컹거리는 과정이 있겠지만 AI 산업은 우상향으로 발전할 수밖에 없다"고 했다.

정의선 현대차그룹 회장은 미국 대선을 앞둔 상황에서 급변하는 대외 경영환경에 대한 준비에 나설 것으로 보인다. 올해 하반기 완공되는 미국 조지아주 '현대차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA)'의 상황을 살펴볼 것으로 전망된다. 최근 미국 연방 정부 당국은 최근 76억 달러(약 10조원) 규모의 현대자동차 조지아주 전기차 공장에 대한 환경 허가를 재검토하기로 한 것으로 알려졌다. 현대의 전기차 공장이 지역 상수도에 미치는 영향을 규제 당국이 제대로 평가하지 못했다는 환경보호 운동가들의 민원이 영향을 끼쳤다. 해당 공장은 이르면 올해 10월 가동 목표였지만, 환경 평가를 다시 받을 경우 계획에 차질을 빚을 전망이다. 또 정 회장은 글로벌 시장에 불어온 전기차 캐즘(일시적 수요 정체)의 정면 돌파를 위해 '2033년까지 10년간 120조원 투자'를 단행하는 미래 경쟁력 확보에 집중하고 있다.

구광모 LG그룹 회장은 가족과 연휴를 보낸 뒤 경영에 나설 것으로 보인다. 특히 LG전자가 하반기부터는 엑사원 3.0이 들어간 LG 제품과 서비스를 출시하는 만큼 AI와 밸류업을 위한 구상을 할 전망이다.

김승연 한화그룹 회장은 서울 종로 자택에서 하반기 경영 구상을 다듬을 예정이다. 장남 김동관 부회장도 외부 일정 없이 각종 현안을 챙길 것으로 알려졌다. 김 부회장은 연휴 기간 올해 초 수립한 회사의 사업 계획을 점검하고 미래 신성장동력 확보에 집중할 것으로 보인다.

정기선 HD현대 부회장은 추석 연휴 기간 개막하는 친환경 선박·에너지 전시회 '가스텍(Gastech) 2024' 행사 방문차 미국 출장길에 오른다. HD현대는 가스텍 후원사다. 정 부회장은 이 행사에서 글로벌 에너지 기업 경영진과 만나 사업 협력을 논의할 예정이다.

이 외에도 4대그룹 총수들은 추석연휴 이후 예정된 윤석열 대통령의 체코 순방 동행을 앞두고 있는 만큼 이를 위한 준비작업도 진행할 것으로 보인다. 특히 대통령 해외 순방에 4대그룹 총수가 총출동하는 것은 올해 들어 이번에 처음이다. 경제사절단은 원전 사업과 관련해 힘을 실어주고 체코 시장 진출과 관련해 다양한 비즈니스 논의를 이어갈 것으로 보인다.

특히 이번 방문 기간 양국에 '무역투자촉진프레임워크(TIPF)' 협정을 체결할 것이라는 관측이 나오는 만큼 금융·에너지·인프라 등 경제·산업 전반에 걸친 포괄적인 협력이 이뤄질 것으로 보여 이에 상응하는 기업 차원에서의 협력 모색이 필요하다.

/양성운 기자 ysw@metroseoul.co.kr

산업부, 7년간 2744억 투자 반도체 첨단패키징 기술 개발

삼성전자·SK하이닉스 등 참여
패키징 산업 협력체계 구축 협약

이승렬 산업통상자원부 산업정책실장이 11일 서울 엘타워 골드홀에서 열린 '반도체 첨단패키징 산업 생태계 강화를 위한 MOU 체결식'에 참석해 인사말을 하고 있다. /산업통상자원부

정부가 반도체 첨단패키징 선도기술 개발에 7년간 2744억원을 투자한다.

산업통상자원부는 11일 오후 서울 양재동 엘타워에서 이승렬 산업정책실장이 반도체 첨단패키징 산업 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

업무협약은 반도체 후공정 분야 최초로 예비타당성 조사를 통과한 '반도체 첨단패키징 선도 기술개발 사업(2025~2031년, 2744억원)'의 성공적인 추진을 위해 마련됐다.

업무협약에는 삼성전자, SK하이닉스, LG화학, 하나마이크론, 한미반도체 등과 OSAT(반도체 조립, 패키징 및 테스트 공정), 소부장, 팹리스 기업들이 참여했다. OSAT, 소부장, 팹리스 기업들은 첨단패키징 기술개발에 필요한 성능평가, 기술자문 및 테스트웨이퍼 등을 칩 제조기업으로부터 제공받아 수요기업 연계형 기술개발을 추진할 수 있게 됐다.

첨단패키징은 반도체 공정 미세화 한계와 AI(인공지능) 기술 발전에 따른 고성능·다기능·저전력 반도체 수요증가에 따라 개별 칩들의 단일 패키지화 필요가 커지면서 핵심 기술로 부상하고 있다. 글로벌 첨단패키징 시장은 2022년 443억달러에서 2028년 786억달러 규모로 성장할 것으로 전망된다.

산업부는 우리 기업이 취약한 첨단패키징 기술을 선정해 글로벌 반도체 공급망내 기술 경쟁 우위를 확보하기 위해 해외 기술 선도기관과 연계한 연구개발 사업을 추진 중이다.

이승렬 산업정책실장은 "글로벌 반도체 첨단패키징 기술 경쟁력 확보를 위해 우리 기업들의 적극적인 기술개발 협력을 요청한다"고 당부하고 "정부도 업계 노력에 발맞춰 반도체 후공정의 견고한 선순환적 생태계 조성을 위해 필요한 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

/세종=한용수 기자 hys@